

2020年2月27日

各 位

会 社 名 T O W A 株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 岡田 博和
(コード番号 6315 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員経営企画本部長 柴原 信隆
TEL (075) 692 - 0251

海外連結子会社の移転に関するお知らせ

当社の台湾における連結子会社である台湾東和半導体設備股份有限公司は、下記のとおり移転いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 移転理由

業容拡大に伴う機能の充実および業務の効率化を目的とした移転です。
移転先ではラボ用の当社製造装置を設置し、複雑なモールドイングプロセスを用いた最先端パッケージ等をお客様自身が実験・試作・評価して頂くことができますようになります。
また、工作機械を設置し、簡易な部品加工については現地で行えるようにすることでお客様対応のスピードアップを図る予定です。装置改造やオーバーホール用の作業場所も備えており、今後もお客様へのより一層のサービス向上を目指してまいります。

2. 移転先所在地

(日本語表記) 台湾新竹市東区公園路 216 巷 3 号 2F

(英語表記) 2F, No.3, Lane 216, Gongyuan Road, East District, Hsinchu 300 Taiwan, R.O.C.
TEL : (+886)3-573-7646 FAX : (+886)3-573-7685

3. 移転日

2020年2月25日(火)

4. 業績に与える影響

2020年3月期における当社連結業績に与える影響は軽微であります。

【参考】当該子会社の概要

(1) 名 称	台湾東和半導体設備股份有限公司
(2) 代表者の役職・氏名	董事長 石田 耕一
(3) 事業内容	半導体製造装置の販売およびアフターサービス
(4) 大株主および持株比率	T O W A 株式会社 (100%)

以 上